

Dane techniczne dla produktu: HEKFPZBT03

OBO/Ackermann Płytki montaż. 4x do modul. puszek podłogowych

OBO/Ackermann Płytki montaż. 1x HDS do modul. puszek podłog.



Dane techniczne

Waga (kg)	0,05
EAN	4055516011640
Sugerowana cena detaliczna	31,50
Min. temperatura otoczenia (°C)	-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)	70

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
OBO/Ackermann Płytki montaż. 4x do modul. puszek podłogowych	HEKFPZBT03
OBO/Ackermann Płytki montaż. 1x HDS do modul. puszek podłog.	
Dodatkowe akcesoria	
S-JACK keston RJ45 STP kat.6a 10GB, 4PPoE 100W, SFB	HSEMRJ6GS2
HSEMRJ6GS2 - 24 sztuki w opakowaniu, 4PPoE 100W, SFB	
S-JACK keston RJ45 STP kat.6a 10GB, 4PPoE 100W, SFB	HSEMRJ6GS1
4PPoE 100W, SFB	
Moduł keystone RJ45 SFB, kat.6A/klasa EA, STP, ISO/IEC 11801	HSEMRJ6GBA
4PPoE (100W), SFB	
Moduł keystone RJ45, kat.6A/klasa EA 10G RE-EMBEDDED, STP	HSEMRJ6GWA
4PPoE (100W), SFA	
Moduł keystone RJ45, kat.6a UTP AWG24-22, Opak: 24	HEKFMAUGI2
4PPoE, SFA	
Moduł keystone RJ45, kat.6a UTP AWG24-22, Opak: 1	HEKFMAUGI1
4PPoE, SFA	
Moduł keystone RJ45, kat.6/klasa E, UTP, De-embedded, Tooll.	HSEMRJ6UWS
ToollessLine (SFA)	